

电子

2026 年 01 月 12 日

CES2026 总结：AI 革命进入新阶段，赋能全场景终端

——行业深度报告

投资评级：看好（维持）

陈蓉芳（分析师）

张威震（分析师）

仇方君（分析师）

chenrongfang@kysec.cn

zhangweizhen@kysec.cn

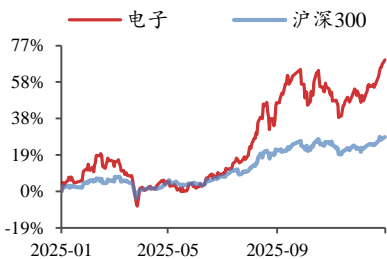
qiufangjun@kysec.cn

证书编号：S0790524120002

证书编号：S0790525020002

证书编号：S0790525050004

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《Vera Rubin NVL72 推出，六芯协同架构重塑 AI 算力基建——行业点评报告》-2026.1.11

《英伟达全新存储架构扩张存储需求，半导体上游持续涨价——行业周报》-2026.1.11

《台积电 2nm 量产提速，全球共振打开 Fab 和设备空间——行业点评报告》-2026.1.8

● AI 芯片：芯片架构/制程工艺持续迭代，AI 推理能效提升、成本下降

AI 芯片方面，CES 2026 英伟达、AMD、英特尔、高通等科技巨头均有亮相。英伟达宣布 Vera Rubin 平台全面投产，Rubin 平台整合 6 颗关键芯片，打造全新的算力、网络与存储架构，在大幅提升性能的同时，AI 推理成本降低 10 倍。AMD 展示其全栈 AI 战略，推动全球算力未来进入 YottaFLOPS 级时代，其推出的基于 MI455X 的 AI 平台 Helios 性能较前代提升 10 倍，并获得 OpenAI 等头部客户认可。英特尔率先发布基于 18A 工艺的酷睿 Ultra 3 系列处理器，核显性能较竞品领先超 70%。高通则推出骁龙 X2 Plus 平台，以更高能效重塑 Windows AI PC 标杆。联想提出“混合 AI”战略，联合芯片厂商构建“端-边-云”全栈能力。整体来看，随着芯片架构和制程工艺迭代，AI 推理性能持续提升，成本持续下降。

● 传统消费电子：AI 手机/AIPC 形态持续创新，软件 AI 交互体验重要性凸显

AIPC 方面，联想推出卷轴屏与外折叠 PC，通过其“混合式 AI”战略赋能 AIPC，构建端云协同、无缝衔接的 AI 交互体验；戴尔、惠普升级旗舰 AIPC 产品，端侧 AI 性能大幅提升；美国 YPlasma 公司推出全球首款等离子散热笔记本，革新消费电子散热方案。AI 手机方面，三星展示无折痕可折叠 OLED 显示方案，或将用于下一代折叠屏手机；荣耀展示全球首款机器人手机 ROBOT PHONE，通过云台摄像头增强端侧 AI 交互体验。整体上看，传统消费电子产品硬件创新逐渐乏力，通过软件和系统层面研发更多 Agent AI 功能，增强 AI 交互体验变得更加重要。

● 新型 AI 终端：AI 眼镜持续创新，新型 AI+硬件全面赋能各类场景

新型 AI 终端正从通用交互加速向深度场景渗透。AI 眼镜方面，中国品牌成为创新主力，雷鸟展示全球首款 eSIM 智能 AR 眼镜，标志着 AR 设备进入独立通信时代；Rokid 发布超轻无屏 AI 眼镜“Rokid Style”，主打“语音优先”交互；XREAL 与 ROG 联合发布 R1 游戏眼镜，支持 240Hz 高刷。同时，AI 大模型正走出软件范畴，深入赋能情感陪伴、运动健康、宠物饲养等细分场景，通过专业化与情感化设计，推动 AI 向个性化演进，标志着 AI 终端产业进入全新阶段。

● 汽车&机器人：物理 AI 模型加速智驾落地，各类具身智能机器人大量涌现

智能汽车方面，英伟达通过开源 Alpamayo 系统降低 L4 研发门槛；吉利、长城等中国车企则快速推动全栈智驾方案迈向量产。出行创新呈现多元化突破，从 Strutt 智能轮椅的“人机共驾”到 Verge 固态电池电动摩托的极致性能，技术正从不同维度深刻重塑未来的出行体验与行业标准。具身智能方面，英伟达通过 Jetson Thor 芯片与 Isaac 平台构建开放生态；波士顿动力发布量产版 Atlas 人形机器人，并与现代、DeepMind 合作推动规模化工业应用；LG 推出家用机器人 CLOiD 及执行器品牌 AXIUM，布局从核心部件到场景生态的全链条。同时，以宇树、智元为代表的中国企业通过高性价比整机、灵巧操作与多元场景方案，在工业自动化、家庭服务等领域展现出快速的商业化能力，全球机器人产业迈向规模化应用新阶段。

● 投资建议

总结来看，AI 仍然是 CES2026 主旋律，而且 AI 正从软件层面更多向物理世界全面融合，持续赋能各类 AI 终端。我们认为，生成式 AI 带来的新一轮创新革命方兴未艾，AI 手机和 AI PC 等传统消费电子产品类有望受益消费者换机而进入周期上行通道，AI 眼镜、具身智能机器人已经跨过“0 到 1”进入“1 到 N”阶段，产品出货量有望保持高速增长。建议重点关注 AI 硬件产业链相关标的。

● 风险提示：宏观经济风险；行业格局恶化风险；AI 产业进展不及预期风险。

目 录

1、 AI 芯片：架构/制程持续演进，AI 计算能效提升成本下降	4
1.1、 英伟达：Vera Rubin 全面投产，AI 推理成本显著下降	4
1.2、 AMD：以全栈 AI 战略推动计算基础设施迈向 Yotta 级时代	6
1.3、 英特尔发布 1.8nm 制程处理器，高通更新 PC 处理器骁龙 X2 Plus	9
1.4、 联想“混合 AI”战略全面进阶，Ambiq 发布首款超低功耗 NPU SoC	10
2、 AI PC：各大厂商围绕 PC 形态和 AI 交互体验持续创新	12
3、 AI 手机：硬件创新趋于乏力，Agent AI 有望持续赋能	14
4、 AI 眼镜：中国品牌引领创新，独立交互与生态拓展成关键	15
5、 新型 AI+硬件：情感交互深化，AI 赋能全场景硬件	16
6、 智能汽车：开源 AI 模型推动高阶自动驾驶加速落地	18
7、 具身智能：各类形态百花齐放，具身智能加速落地	20
8、 投资建议	23
9、 风险提示	24

图表目录

图 1： Rubin GPU 实现 50 PFLOPS 的推理性能	4
图 2： Vera CPU 集成 88 个定制的 Olympus Arm 核心	4
图 3： BlueField-4 负责上下文与数据调度	5
图 4： NVLink-6 负责 GPU 内部协同计算	5
图 5： ConnectX-9 SuperNIC 支持 800 Gb/s 以太网	5
图 6： 每颗 Spectrum-6 芯片提供 102.4 Tb/s 的带宽	5
图 7： 相比 Blackwell 平台，Rubin 单位 Token 的推理效率提升最高可达 10 倍	6
图 8： AMD 推出下一代机架级 AI 平台 Helios	6
图 9： AMD MI455X 的性能比 MI355X 提高了 10 倍	7
图 10： 2027 年 AMD 将发布 MI500 系列	7
图 11： OpenAI 联合总裁 Greg Brockman 罕见现身 AMD 活动	8
图 12： AMD 推出 Ryzen AI 400 系列处理器	8
图 13： 酷睿 Ultra 3 系列使用 Intel 18A 工艺	9
图 14： Panther Lake 架构核显性能较竞品领先超 70%	9
图 15： 骁龙 X2 Plus 集成第三代 Qualcomm Oryon CPU 并配备 80TOPS NPU	10
图 16： 骁龙 X2 Plus：CPU/GPU/NPU 性能全面跃升	10
图 17： 联想与 AMD 合作推出基于 Helios 机架级架构的 AI 推理服务器	11
图 18： Ambiq 发布全球首款基于超低功耗 SPOT 技术的 NPU SoC	11
图 19： 联想推出可卷曲概念及的新产品 Legion Pro	12
图 20： ThinkPad Rollable XD 采用全球首批外折叠设计	12
图 21： 惠普发布最小、最轻的 AI PC EliteBoard G1a	12
图 22： OmniBook Ultra 14 或搭载骁龙处理器	12
图 23： 戴尔重磅发布全新 XPS 14 与 XPS 16 笔记本电脑	13
图 24： DBD 技术首次被微型化至重新定义硬件设计的形态	13
图 25： 三星展示的无折痕可折叠 OLED 屏幕较现有折叠屏手机改善明显	14
图 26： 荣耀推出全球首款机器人手机 ROBOT PHONE	14

图 27: 雷鸟首款 eSIM 智能眼镜亮相 CES2026	15
图 28: Rokid 发布超轻无屏 AI 眼镜“Rokid Style”	16
图 29: 华硕与 Xreal 推出合作款眼镜	16
图 30: 宇灵无限推出的 AI 萌宠 BOOBOO	17
图 31: ThingX 展出情绪监测吊坠 Nuna	17
图 32: 喜乐健的家庭治疗舱 2.0 获得 CES 2026 创新奖	17
图 33: 玖治科技 Ringconn 打造智能戒指	17
图 34: Bird Buddy 的智能喂鸟器已经形成完整生态	18
图 35: 出门问问打造 AI 录音卡片 TicNote	18
图 36: Alpamayo 是首款用于辅助驾驶的开源 VLA 推理模型	18
图 37: 吉利全域 AI 技术体系全面升级, 进阶到 2.0 时代	19
图 38: Strutt 发布的 Ev1 智能电动轮椅	19
图 39: Verge 电动摩托车搭载固态电池	19
图 40: 英伟达通过新一代 Jetson Thor 芯片, 为人形机器人提供高性能计算平台	20
图 41: 波士顿动力在 CES2026 上发布全电动人形机器人 Atlas 的量产商用版本	21
图 42: LG 推出首款人形机器人 CLOiD	21
图 43: 宇树科技展示“机器人格斗赛”	23
图 44: 智元机器人首次亮相海外	23
表 1: 英伟达 Rubin 计算平台整合 6 颗关键芯片	4
表 2: 中国机器人企业集体亮相 CES2026	22
表 3: 受益标的盈利预测与估值	23

1、AI 芯片：架构/制程持续演进，AI 计算能效提升成本下降

1.1、英伟达：Vera Rubin 全面投产，AI 推理成本显著下降

Vera Rubin 平台正式亮相，全面投产。美国当地时间 1 月 5 日，英伟达以人工智能之力开启 2026 年国际消费电子展（CES 2026）。在大会上，英伟达 CEO 黄仁勋宣布，新一代 AI 芯片平台 Vera Rubin 全面投产。相较上一代 Blackwell 架构，Rubin 平台 AI 训练性能提升 3.5 倍，单位 Token 推理效率最高可提升 10 倍。

Rubin 平台采用极致协同设计理念，整合 6 颗关键芯片。英伟达 Vera Rubin NVL72 计算平台由 6 颗关键芯片组成，包括 Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 交换芯片、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 数据处理单元和 Spectrum-6 以太网交换芯片。这些更新共同构成了 Vera Rubin NVL72 机架级系统，直指当前 AI 推理面临的高成本、有限上下文长度和规模化瓶颈，旨在系统性解决让 AI“多想一会、算得起、跑得久”的问题，从而实现推理成本进一步下降。

表1：英伟达 Rubin 计算平台整合 6 颗关键芯片

组件	作用
Vera CPU	专为 AI 数据流与调度设计的新一代 CPU
Rubin GPU	接替 Blackwell 的下一代训练/推理 GPU
NVLink 6	GPU 之间的超高速互联
ConnectX-9 SuperNIC	AI 专用网络接口
BlueField-4 DPU	数据中心级安全与数据卸载
Spectrum-6 Ethernet	面向超大规模 AI 集群的交换网络

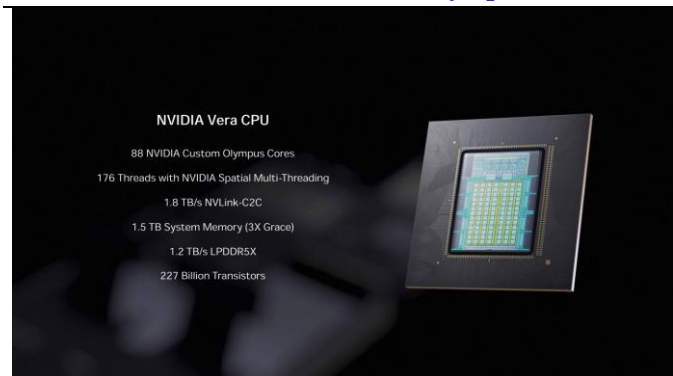
资料来源：新智元公众号、开源证券研究所

图1：Rubin GPU 实现 50 PFLOPS 的推理性能



资料来源：英伟达官网

图2：Vera CPU 集成 88 个定制的 Olympus Arm 核心

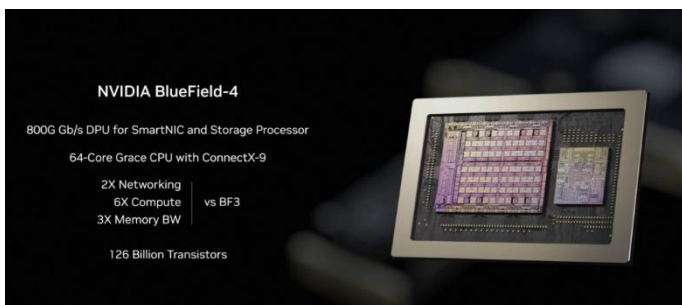


资料来源：英伟达官网

Rubin 平台围绕长期推理需求，打造全新算力、网络与存储架构。在计算核心上，Rubin GPU 采用 NVFP4 格式，实现推理与训练性能较前代 Blackwell GB200 提升达 5 倍与 3.5 倍，并配备 8 个 HBM4 高带宽显存予以支撑；在互联层面上，通过 NVLink 6 在机架内构建高达 260TB/s 的超高速网络，并借助 Spectrum-X 以太网实现机架间高效扩展，以适配 MoE 等复杂模型对通信的苛刻需求；在系统层面上，创新引入了基于 BlueField-4 DPU 的推理上下文内存存储平台，以经济方式突破长上下文处理的瓶颈。此外，该架构首次将可信执行环境扩展至整个机架，并通过模块化无电缆设计、增强的 NVLink 弹性与第二代 RAS 引擎，实现了高安全性与接近零停机的可靠性。通过上述计算、网络、存储与安全的系统性革新，Rubin 平台在追求极致

性能的同时，大幅降低 AI 推理的总体拥有成本。

图3: BlueField-4 负责上下文与数据调度



资料来源：英伟达官网

图4: NVLink-6 负责 GPU 内部协同计算



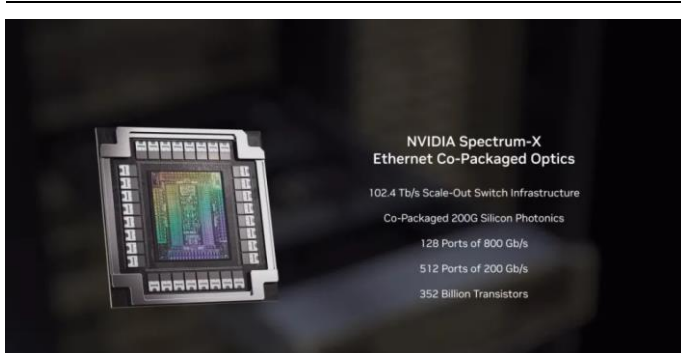
资料来源：英伟达官网

图5: ConnectX-9 SuperNIC 支持 800 Gb/s 以太网



资料来源：英伟达官网

图6: 每颗 Spectrum-6 芯片提供 102.4 Tb/s 的带宽



资料来源：英伟达官网

Rubin 平台将 AI 推理成本降低 10 倍。相比上一代 Blackwell NVL72 架构,Rubin 可将推理阶段的 Token 成本最高降低 10 倍,并将训练混合专家模型(MoE)所需的 GPU 数量减少至原来的 1/4。

Rubin 平台现已全面投产,预计 2026 下半年推出。AWS、Google Cloud、Microsoft、OCI 以及 NVIDIA 云合作伙伴 CoreWeave、Lambda、Nebius 和 Nscale 在内的领先云提供商,计划在 2026 年率先部署基于 Vera Rubin 的实例,其中微软将在其下一代 AI 数据中心(包括未来的 Fairwater AI 超级工厂)中引入 NVIDIA Vera Rubin NVL72 机架级系统。

服务器方面,思科、Dell、HPE、联想和超微等厂商预计将推出基于 Rubin 的各类服务器。同时,Anthropic、Cohere、Meta、Mistral AI、OpenAI、xAI 等领先 AI 实验室也计划借助 Rubin 平台训练更强大的模型,并以更低延迟和成本服务于长上下文、多模态系统。此外,基础设施软件和存储领域的合作伙伴,如 Canonical、DDN、Dell、HPE、IBM、NetApp、Pure Storage、VAST Data 和 WEKA 等,正与 NVIDIA 合作,为 Rubin 基础设施开发下一代平台。

我们认为,Rubin 平台将系统性降低 AI 推理成本与部署门槛,加速长上下文、多模态等复杂 AI 应用迈向规模化落地。同时,通过从芯片到机架的全栈协同设计,英伟达正进一步强化其 AI 算力生态壁垒,推动行业竞争从单一硬件性能转向系统级效率与成本竞争。

图7：相比 Blackwell 平台，Rubin 单位 Token 的推理效率提升最高可达 10 倍

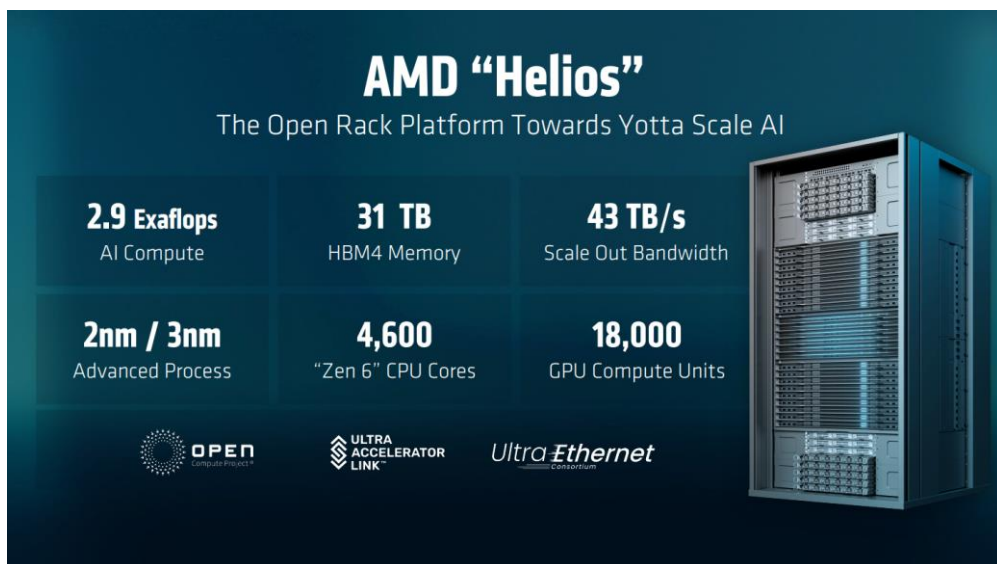


资料来源：英伟达官网

1.2、AMD：以全栈 AI 战略推动计算基础设施迈向 Yotta 级时代

AMD 展示全栈 AI 战略，推动全球算力进入 Yotta 级算力时代。在 CES 2026 上，AMD 董事会主席兼 CEO 苏姿丰系统阐述了其全栈 AI 战略，覆盖从云端数据中心到边缘设备、从硬件平台到软件生态的完整链条。其核心目标是推动全球计算能力在未来几年内提升 100 倍，以支撑 AI 用户从目前的 10 亿增长至 2030 年 50 亿的规模化需求，并迈向 YottaFLOPS (10^{24} FLOPS) 级别的算力时代。

图8：AMD 推出下一代机架级 AI 平台 Helios

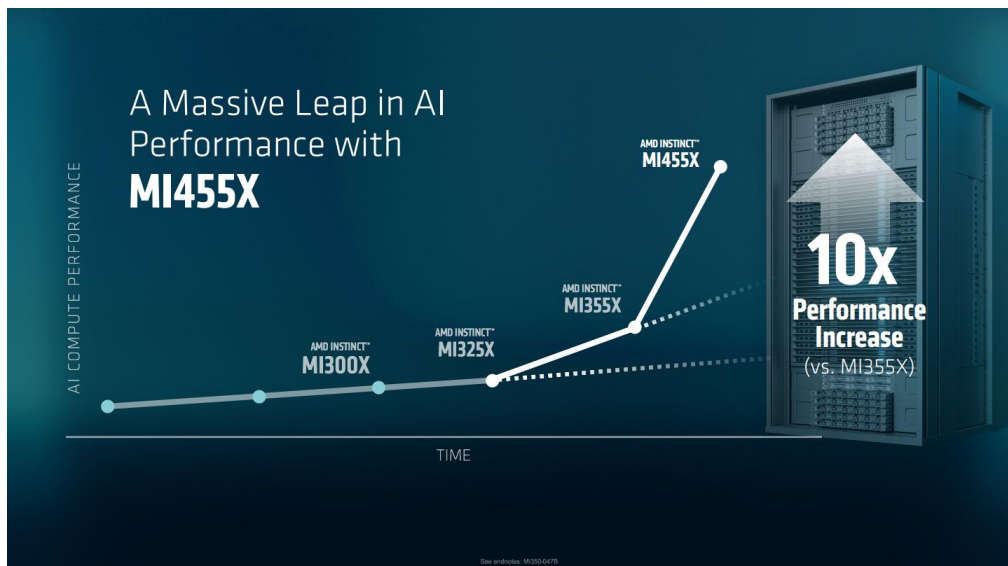


资料来源：AMD 官网

AMD 推出基于 MI455X 的下一代开放架构 AI 平台 Helios 服务器，性能提升 10 倍。在 CES 2026 上，AMD 发布重量达 7000 磅的下一代机架级 AI 平台 Helios，该平台采用全液冷设计，每个计算托盘集成 4 块 MI455X GPU、EPYC Venice Zen 6 CPU 及 Pensando 网络芯片，实现芯片级协同。单机架可搭载最多 72 块 MI455X GPU，提供 2.9 exaFLOPS 的 FP4 计算能力、31TB HBM4 内存及 43 TB/s 的横向扩展带宽，旨

在支撑超大规模 AI 训练与推理。MI455X 作为 AMD 史上最先进的处理器，采用 2nm/3nm 工艺，集成 3200 亿个晶体管，配备 432GB HBM4，性能较前代 MI355X 提升 10 倍。

图9：AMD MI455X 的性能比 MI355X 提高了 10 倍

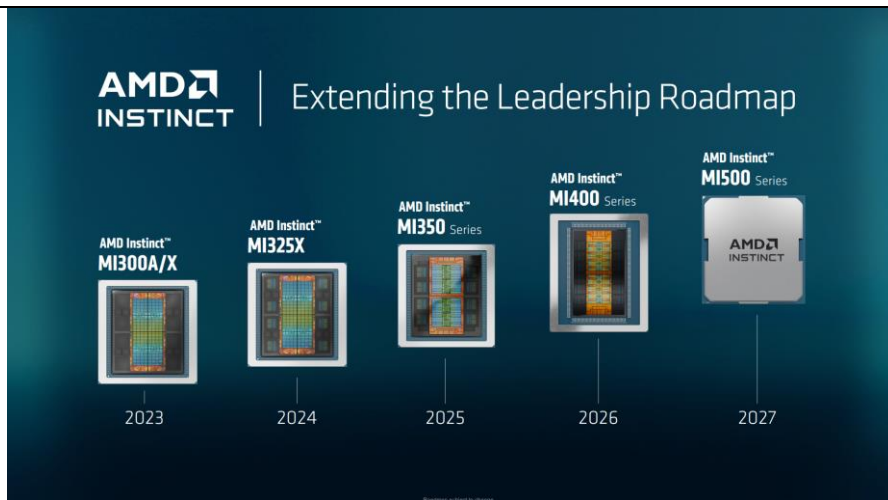


资料来源：AMD 官网

AMD Instinct 系列升级路线清晰，下一代 MI500 系列计划在 2027 年面世。MI500 系列被定位为实现“四年 AI 性能提升 1000 倍”目标的关键一步。其核心规格标志着一次全方位的世代飞跃：采用全新的 CDNA 6 架构，升级至更先进的 2nm 制程工艺，并率先搭载带宽更高的 HBM4e 内存。这一组合旨在实现算力、能效与内存带宽的协同突破。

从竞争格局看，AMD 此次的发布节奏已与英伟达近乎同步。英伟达从 Blackwell 到 Rubin 的周期约为 18-24 个月，而 AMD 从 MI400 系列(2026)到 MI500 系列(2027)的迭代周期预计缩短至约 12 个月。这表明 AMD 正全力追平顶级芯片的研发与发布节奏，为市场提供更具竞争力的替代选择，从而重塑 AI 算力市场的竞争动态。

图10：2027 年 AMD 将发布 MI500 系列



资料来源：AMD 官网

与 OpenAI 宣布达成一项重大战略合作，双方将开展为期多年、总规模达 6 吉瓦的多代产品合作。根据协议，AMD 将使用其 Instinct GPU 为 OpenAI 的下一代 AI 基础设施提供算力支持，首批 1 吉瓦的 MI450 GPU 计划于 2026 年下半年部署。

在此次 CES2026 上，OpenAI 联合总裁 Greg Brockman 罕见现身 AMD 活动，指出 AI 正从“文本框”演进为“代理舰队”，并强调未来经济增长（GDP 上限）将受制于可用算力规模，此举明确释放出 OpenAI 致力多元化算力供应链的信号。与此同时，生成视频公司 Luma AI 表示已将 60% 的推理负载迁移至 AMD 平台，而“AI 教母”李飞飞也展示了其 World Labs 在空间智能领域对 AMD 高性能硬件的依赖。我们认为，这些案例共同表明，AMD 的 Instinct GPU 已获得前沿 AI 研究及商业应用核心圈层的认可，其算力生态正逐步成熟，成为支持下一代 AI 创新的关键基础。

图11: OpenAI 联合总裁 Greg Brockman 罕见现身 AMD 活动



资料来源：智东西公众号

图12: AMD 推出 Ryzen AI 400 系列处理器



资料来源：AMD 官网

AMD 发布消费级 Ryzen AI 400 系列处理器，提升本地模型运行效能。面向终端市场，AMD 推出 Ryzen AI 400 系列处理器，搭载 Zen 5 CPU、RDNA 3.5 GPU 与 XDNA 2 NPU，NPU 算力最高达 60 TOPS，支持更快的内存速度。首批搭载该系列的 PC 将于 2026 年第一季度上市，全年计划推出超过 120 款设计。针对高端创作者与开发者，AMD 更新 Ryzen AI Max+ 系列，配备 40 核 RDNA 3.5 GPU 核心，支持

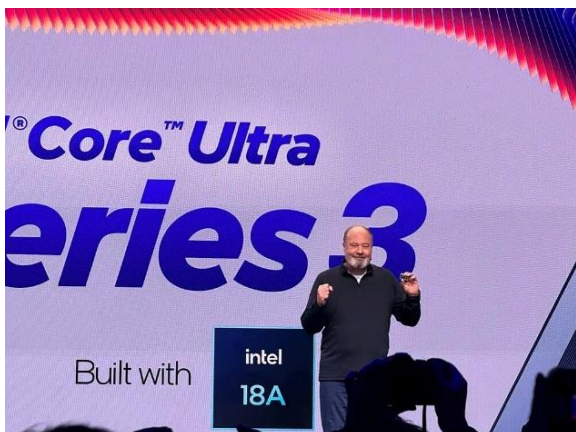
128GB 统一内存，总算力达 60 TFLOPS，可运行 140 亿参数模型。同时，预装开源工具与模型的开发平台 Ryzen AI Halo 将于 2026 年第二季度上市，有望降低 AI 应用开发门槛。

1.3、英特尔发布 1.8nm 制程处理器，高通更新 PC 处理器骁龙 X2 Plus

英特尔：发布全球首款 1.8nm 芯片酷睿 Ultra 3 系列。在 CES2026 上，英特尔 CEO 陈立武及多位高管正式发布了基于 Intel 18A 工艺节点的下一代客户端处理器——酷睿 Ultra 3 系列（代号 Panther Lake），集中展现了英特尔在制程迭代、架构设计、AI 与图形性能提升以及边缘布局上的系统化进展。

Panther Lake 处理器提供三种核心配置：包括配备 4 个 Xe3 核显的 8 核（4P+4LE-E）版本、配备 4 个 Xe3 核显的 16 核（4P+8E+4LP-E）版本，以及搭载 12 个 Xe3 核显（即锐炫 Arc B390 级别核显）的 16 核（4P+8E+4LP-E）高性能版本。该系列标志着 Intel 18A 制程首次实现规模化商用——其计算模块全面采用该工艺，而图形模块则依据配置分别采用台积电 N3E（12 核显版本）与 Intel 3（4 核显版本）工艺，平台控制模块则使用台积电 N6 工艺，最终通过 Foveros-S 先进封装技术集成于单一 SOC 芯片中。

图13：酷睿 Ultra 3 系列使用 Intel 18A 工艺



资料来源：智东西公众号

图14：Panther Lake 架构核显性能较竞品领先超 70%

Panther Lake Package Configurations			
8 core		16 core	16 core 12X*
Up to 8 cores		Up to 16 cores	
Up to 4X* cores		Up to 12X* cores	
GPU		GPU	
NPU 5		NPU 5	
IPU 7.5		IPU 7.5	
Media & display		X* media & display engine	
Memory		Memory	
LPDDR5X DDR5 SO-DIMM		LPDDR5X DDR5 SO-DIMM	
12x PCIe lanes		20x PCIe lanes	
Connectivity		Connectivity	
Intel® Wi-Fi 7 (R2) & Intel® Bluetooth® Core 6, Thunderbolt™ 5 and 4		Intel® Wi-Fi 7 (R2) & Intel® Bluetooth® Core 6, Thunderbolt™ 5 and 4	

资料来源：PCEVA 测评室公众号

高通：骁龙 X2 Plus 平台亮相，以能效与 AI 算力重塑 Windows AI PC 标杆。在 CES 2026 上，高通推出了骁龙 X 系列的最新平台——骁龙 X2 Plus，旨在为下一代 Windows 11 AI+ PC 树立性能、能效与 AI 体验的新标杆。该平台面向追求高效多任务处理、长续航与智能体验的专业人士与创作者，OEM 终端预计将于 2026 年上半年上市。

骁龙 X2 Plus 系列在性能与能效上实现大幅提升。根据高通公布的数据，十核型号 X2P-64-100 在 Geekbench 6 测试中，单核性能较同规格前代 X1P-64-100 提升 35%，多核性能提升 17%。这一提升一方面源于其最高频率较前代提高 17%，另一方面也得益于 Oryon 架构的优化。而六核型号 X2P-42-100 在核心数减少的情况下，仍实现单核性能 35% 的提升，体现高通通过调整核心策略以优先保障能效表现的思路，旨在应对此前八核设计在能效上面临的挑战。

综合性能表现上，骁龙 X2 Plus 实现了对前代及 x86 竞品的双重超越。其单核性能在 Geekbench 6.5 中较 x86 竞品领先 28%，最高频率突破 4GHz，显著提升单线程任务响应速度。多核性能方面，十核与六核型号分别较前代提升 17% 与 10%，并搭

配最高 24MB L2 缓存及 LPDDR5x-9523 内存（带宽达 128GB/s），为高负载多任务应用提供了坚实的性能与带宽支撑。

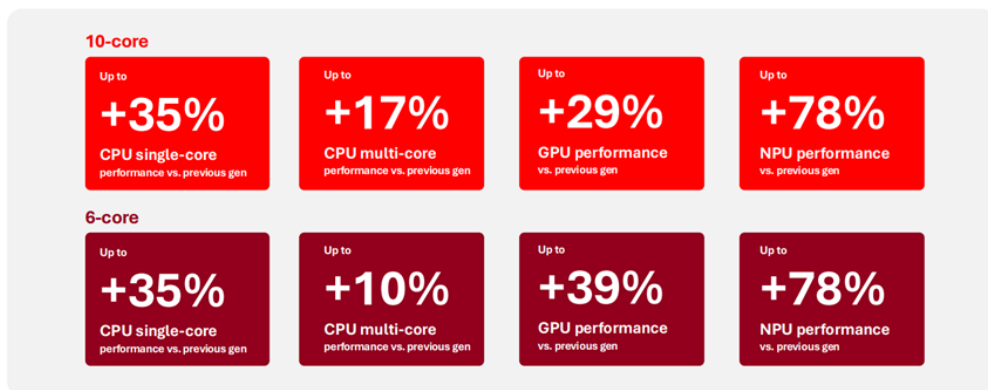
图15：骁龙 X2 Plus 集成第三代 Qualcomm Oryon CPU 并配备 80TOPS NPU



资料来源：高通中国公众号

图16：骁龙 X2 Plus：CPU/GPU/NPU 性能全面跃升

Incredible Performance, Extraordinary Possibilities



CPU performance is based on Geekbench v6.0 Single-Core and Multi-Core scores on Windows 11 OS, run in December 2025. GPU performance is based on 3DMark Steel Nomad Light v2.00-0040 scores on Windows 11 OS, run in December 2025. NPU performance is based on INT8 TOPS performance calculation. Snapdragon X2 Plus (DP-400-100) was tested using a Qualcomm reference design. Snapdragon X Plus (DP-400-100) was tested using a Qualcomm reference design.

Snapdragon X2 Plus



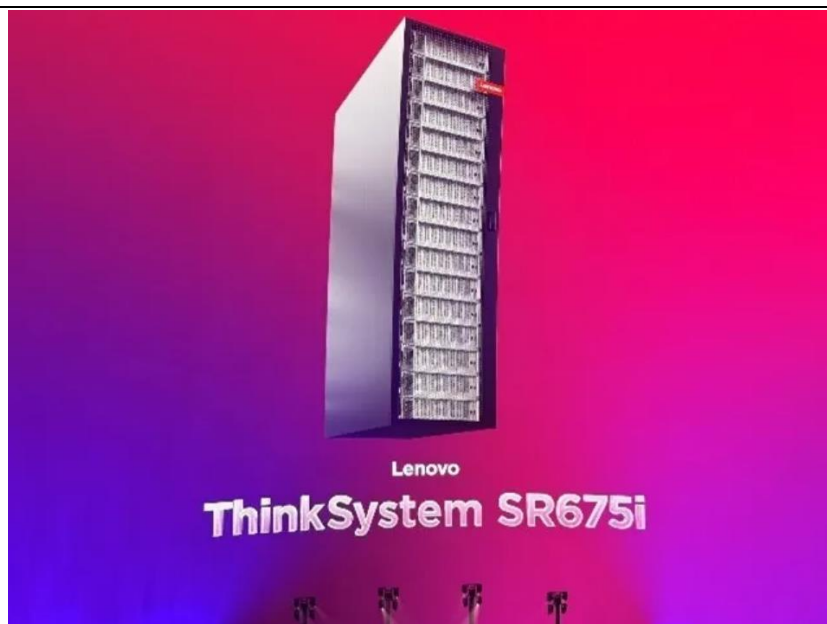
资料来源：高通

1.4、联想“混合 AI”战略全面进阶，Ambiq 发布首款超低功耗 NPU SoC

联想：“混合 AI”战略驱动“端-边-云”全栈布局。在 CES 2026 上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆提出了以“普惠”与“个性化”为核心的“混合式 AI”战略构想，强调通过个人、边缘与云端智能的协同实现 AI 技术的规模化落地。为实现该愿景，联想发布了智能模型编排、智能体内核与多智能体协作三大核心技术，并推出海外市场首款个人 AI 助手 Qira，以动态调度模型资源，提升跨设备协同体验。

联想积极联合关键合作伙伴构建 AI 算力生态：一方面与 AMD 合作推出基于 Helios 机架级架构的 AI 推理服务器 ThinkSystem SR675i，另一方面依托 NVIDIA 平台启动“AI 云超级工厂”计划，以支持未来数十万 GPU 规模的云服务扩展。这一系列举措系统性地展现了联想以芯片及算力合作为基石，打通从终端设备到边缘推理乃至云端训练的全栈 AI 能力，旨在降低应用门槛并提升全场景推理效率。

图17：联想与 AMD 合作推出基于 Helios 机架级架构的 AI 推理服务器



资料来源：Counterpoint

Ambiq：超低功耗 NPU 突破边缘 AI 能效瓶颈。本届 CES 上，Ambiq 发布了全球首款基于超低功耗 SPOT 技术的 NPU SoC——Atomiq，标志着端侧 AI 能效比的显著突破。该芯片集成 Arm Ethos-U85 NPU，提供超过 200 GOPS 的 AI 算力，支持常开型音频处理、计算机视觉及复杂推理任务，可应用于智能穿戴、工业传感器与消费电子等领域。通过完整的软件工具链（如 Helia AI、neuralSPOT SDK），Ambiq 降低了小型设备部署 AI 模型的门槛。此外，公司展示下一代 12nm SPOT 平台，进一步优化能效并扩展模型支持范围。生态合作方面，Ambiq 与 Ronds 在重工业领域部署超 40 万个智能传感器，并与 Bravechip 共同开发智能戒指等产品，巩固了其在超低功耗边缘 AI 市场的技术领导地位。

图18：Ambiq 发布全球首款基于超低功耗 SPOT 技术的 NPU SoC



资料来源：Counterpoint

2、AI PC：各大厂商围绕 PC 形态和 AI 交互体验持续创新

联想：推出卷轴屏与外折叠 PC，产品形态持续创新。在 AI PC 方面，联想集中展示了两大 AI 驱动的突破性概念产品，体现其从硬件制造向 AI 生态整合的升级路径。ThinkPad Rollable XD 作为全球首批“外卷式”设备，配备可从 13.3 英寸展开至 16 英寸的柔性屏幕，实现屏幕面积提升 50%，支持触控与语音交互，适用于混合办公、数字标牌等多种场景。另一核心产品 Personal AI Hub（Project Kubit）定位为个人边缘云中枢，集成英伟达 GB10 超级芯片与双 AI 工作站，能够跨设备聚合数据、进行个性化推理并实现持续自进化，与 ThinkBook Auto Twist 等 AI PC 设备共同构建无缝衔接的 AI 交互新范式，突出联想在场景感知、本地算力与多模态融合方面的技术方向。

图19：联想推出可卷曲概念及的新产品 Legion Pro



资料来源：Lenovo 官网

图20：ThinkPad Rollable XD 采用全球首批外折叠设计



资料来源：Lenovo 官网

惠普：多款创新 AI PC 产品，定义未来办公场景的灵活性与高效性。CES2026 上，惠普发布了多款创新 AI PC 产品，旨在重新定义未来办公场景的灵活性与高效性。其中，惠普 EliteBoard G1a 作为品牌迄今最小、最轻的 AI PC，重量仅 0.75 千克，将全功能融入键盘设计，满足移动办公需求，并荣获 2026 年度 CES 创新奖；惠普 EliteBook X G2 商用笔记本系列重量为 1 公斤，支持最高 180 TOPS 的 AI 算力和 5G 全时互联，同样获得 CES 创新奖；此外，OmniBook Ultra 14 等消费级笔记本搭载新一代 Intel Core Ultra 处理器，在便携性、性能和续航方面实现平衡。这些产品共同体现了惠普通过 AI 技术赋能高效、个性化工作体验的战略方向。

图21：惠普发布最小、最轻的 AI PC EliteBoard G1a



惠普EliteBook X G2商用笔记本系列

资料来源：中国惠普公众号

图22：OmniBook Ultra 14 或搭载骁龙处理器



惠普OmniBook Ultra 14

资料来源：中国惠普公众号

戴尔：升级 XPS 旗舰 PC 产品，AI 性能大幅提升。戴尔科技发布全面升级的 XPS 14 和 XPS 16 笔记本电脑，新品延续了系列标志性的精致设计和精湛工艺，并在便携性、操作体验、性能及显示效果上实现显著提升：机身采用一体化结构和高端材质，增强耐用性并优化细节；搭载英特尔酷睿 Ultra 3 系列处理器与锐炫显卡，AI 性能提升最高达 78%，图形性能提升超 50%，并通过创新散热系统兼顾高性能与低温静音；配备 OLED 或 2K LCD 屏幕选项，支持长达 40 小时以上的本地视频播放；同时产品深度融入可持续理念，采用模块化接口与回收材料，并计划在 2026 年晚些时候推出更轻薄的 XPS 13 机型，进一步扩展产品矩阵。

图23：戴尔重磅发布全新 XPS 14 与 XPS 16 笔记本电脑



资料来源：DELL 公众号

其他品牌：全球首款 DBD 等离子散热静音笔记本电脑官宣 CES。在 CES 2026 上，美国公司 YPlasma 发布全球首款采用介质阻挡放电（DBD）等离子散热技术的笔记本电脑，这标志着消费电子散热方案的一次重大革新。该技术通过全固态薄膜（仅厚 200 微米）产生高速“离子风”进行散热，彻底取代了传统风扇，实现了真正静音（运行音量仅 17 分贝）运行，并为超薄笔记本电脑设计提供了可能。相较于早期的离子风技术，DBD 方案在安全性上实现了根本性跨越，它不会产生有害臭氧，且可靠性更高，寿命可与设备同步。此外，该技术还是全球首款能同时实现制冷与加热的散热元件。YPlasma 表示，这项源自航空航天领域的技术未来还有望跨界应用于车辆、飞行器等领域，以提升能效和推进技术。

图24：DBD 技术首次被微型化至重新定义硬件设计的形态

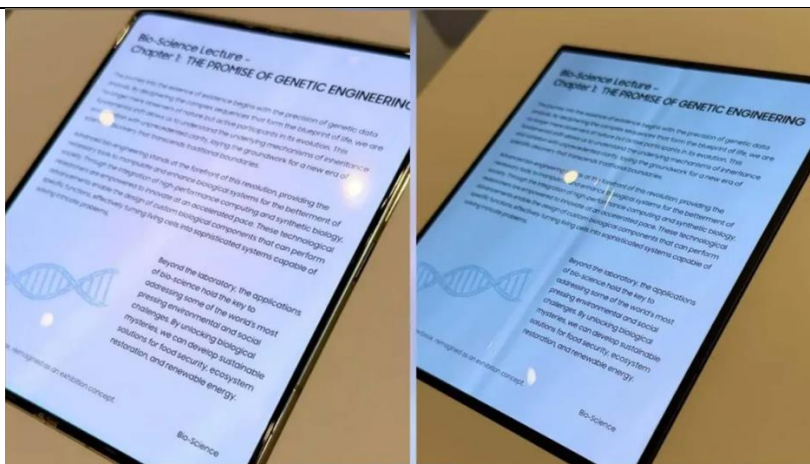


资料来源：笔吧评测室公众号

3、AI 手机：硬件创新趋于乏力，Agent AI 有望持续赋能

三星展示无折痕可折叠 OLED 显示方案，或将用于下一代折叠屏手机。在 CES 2026 上，三星展示了专为 Galaxy Z Fold 8 设计的无折痕可折叠 OLED 面板，标志着折叠屏技术在解决长期存在的折痕问题上取得重要进展。目前，该项技术的应用前景明朗，其能否量产主要取决于三星移动体验（MX）部门对价值链的整合决策。值得关注的是，此项技术突破也预示着可折叠设备市场将迎来新一轮升级周期，苹果等厂商的跟进将进一步加速无折痕技术的普及与创新。我们认为，无折痕屏幕已成功从实验室走向展示舞台，其商业化应用将极大提升用户体验，并推动折叠屏手机市场进入全新发展阶段。

图25：三星展示的可折叠 OLED 屏幕较现有折叠屏手机改善明显



资料来源：果粉之家公众号

荣耀发布全球首款机器人手机——ROBOT PHONE，通过云台摄像头增强端侧 AI 交互体验。该手机凭借可一键展开的机械结构，实现了全自动构图、智能跟随与云台级物理防抖，在防抖角度与画质保持上超越了传统光学防抖方案，结合计算摄影可支持更长曝光时间，显著提升影像能力。同时，其搭载的端侧大模型 YOYO 具备情感感知与主动服务能力，可承担个人助理、内容推荐及跨设备调度等任务。荣耀官方表示，该产品初衷在于突破移动影像防抖与视频性能的天花板，并在基础功能上致力于提供超越专业设备的体验，其“可思考的 AI 大脑”与创新的可变形结构或将共同定义下一代智能终端的交互与创作形态。

图26：荣耀推出全球首款机器人手机 ROBOT PHONE



资料来源：科技每日推送公众号

我们认为，手机作为一个成熟品类，由于对体积、重量要求较高，在硬件外观

和配置上创新空间有限，近几年除了双折叠、三折叠手机等形态创新外，手机厂商逐渐将研发重心转移到 AIOS 开发和 AI Agent 智能助手的研发方面。2026 年，随着各大厂商持续投入研发，AI 手机有望出现更多好用、实用的 AI 功能玩法。

4、AI 眼镜：中国品牌引领创新，独立交互与生态拓展成关键

中国智能眼镜企业成为 CES 展会焦点，AI 眼镜正进入规模化发展的新阶段。雷鸟创新宣布推出全球首款 eSIM 智能眼镜；Rokid 推出支持多 AI 引擎的轻量级 AI 眼镜 Rokid Style；XREAL 则与华硕合作推出首款 240Hz 高刷电竞眼镜 ROG Xreal R1，并与谷歌合作开发 AR 眼镜 Project Aura。此外，联想发布个人 AI 眼镜概念产品，极米科技跨界推出 AI 眼镜品牌 MemoMind。政策方面，中国首次将智能眼镜纳入数码产品购新补贴范围，IDC 预计 2026 年全球出货量将突破 2368.7 万台，其中中国市场达 491.5 万台。在英伟达与联想等巨头深化 AI 合作、产品技术持续突破的背景下，智能眼镜正从概念验证迈向普及化增长新阶段。

雷鸟创新：以 eSIM 开启 AR 独立通信新时代。在 CES 2026 开幕前，雷鸟创新宣布完成 10 亿元以上新一轮融资，由中国移动链长基金和中信金石领投，多家机构跟投。基于 2025 年蝉联中国 AR 市场第一的表现，公司宣布将在 2026 年开启“AI+AR 黄金时代”，其核心举措是在本次 CES 上首次以真机形态展示全球首款 eSIM 智能眼镜——雷鸟 X3 Pro Project eSIM。该产品通过集成 eSIM 通信模块支持 4G 网络，在仅比前代增重 2 克的情况下，实现了让 AR 眼镜脱离手机独立使用，标志着 AR 设备进入独立通信的新时代。

图27：雷鸟首款 eSIM 智能眼镜亮相 CES2026



资料来源：雷鸟创新公众号

Rokid：定义“语音优先”超轻 AI 眼镜。中国厂商 Rokid 发布了超轻无屏 AI 眼镜“Rokid Style”，主打“语音优先”交互，整机仅重 38.5 克，支持佩戴者自由切换调用 ChatGPT、DeepSeek、Qwen 等多平台大模型，并整合谷歌地图导航与微软 AI 翻译等功能。该眼镜提供定制化镜片服务，覆盖近视、散光等多种矫正需求，并可选配光致变色等功能镜片，定制周期为 7-10 天。采用双芯片架构实现 12 小时日常续航，配备 1200 万像素索尼传感器支持 4K 拍摄，并针对佩戴舒适性采用钛合金铰链与硅胶鼻垫设计。产品起售价 299 美元，主要面向日常需 AI 辅助及常需跨语言沟通、内容创作的群体，于 1 月 19 日全球发售。

图28: Rokid 发布超轻无屏 AI 眼镜 “Rokid Style”



资料来源: AI 出海观察公众号

XREAL: 定义高刷新率游戏眼镜新标准。华硕 ROG 与 Xreal 联合推出的 ROG XREAL R1 游戏眼镜, 以可穿戴形态提供等效 171 英寸的虚拟巨幕体验。其搭载 240Hz 刷新率微 OLED 全高清屏幕与 57° 视场角, 保障了游戏画面的流畅与清晰。产品具备画面随头转动的默认模式与可固定于空间的锚定模式, 内置 3D 景深、环境光自适应功能及 Bose 音频技术。通过 USB-C 接口可广泛连接手机、掌机等设备, 配套的 ROG Control Dock 扩展坞支持多设备一键切换与视频接口扩展。该产品已纳入 ROG 全新生态矩阵, 代表了高端游戏品牌在可穿戴显示领域的重要布局。

图29: 华硕与 Xreal 推出合作款眼镜



资料来源: XR 控公众号

5、新型 AI+硬件: 情感交互深化, AI 赋能全场景硬件

(1) AI+陪伴类硬件: AI 陪伴类硬件的多元化创新, 重点聚焦于情感交互与场景化应用。中国企业在其中表现突出, 例如宇灵无限的飞行 AI 萌宠 BOOBOO 通过动作与灯光建立情绪连接, 物启科技 (ThingX) 展出的情绪监测吊坠 Nuna 以外观如常饰、端侧运行核心模型的方式, 实现了隐私优先的长期情绪理解功能, 玄源科技推出跨设备联动的家庭机器人 Yonbo X1 及低价口袋助手 AIPi。海外企业如三星 Ballie 搭载 Gemini 3 模型尝试家庭管家角色, 松下 NICOBO 则以“不完美”设计强化

陪伴感。此外，针对老年群体的仿生熊猫安安、教育场景的 Dex 语言学习相机等产品，均体现了 AI 硬件在细分领域的深度渗透。

图30：宇灵无限推出的 AI 萌宠 BOOBOO



资料来源：智东西公众号

图31：ThingX 展出情绪监测吊坠 Nuna



资料来源：智东西公众号

(2) AI+智能家居硬件：智能家居领域的 AI 技术转向心理健康与个性化环境调控。韩国 Ceragem 的家庭治疗舱 2.0 获创新奖，通过本地计算动态调整环境参数；追觅旗下希瑞聚焦睡眠生态，协同床垫、家纺监测多项指标。AI 与艺术结合的产品如 Fraimic 智能画布支持自然语言生成画作，而欧莱雅 K-Scan、Glyde 智能理发器等则切入个护细分场景。中国品牌卧安机器人的 Obboto 台灯通过 AI 驱动情绪动画，成为年轻用户关注的交互亮点。

(3) AI+运动健康硬件：运动健康类硬件向医疗级监测与跨物种数据共享演进。中国企业玖治科技的智能戒指提供血氧、呼吸暂停等医疗级数据追踪；脑回录科技的前额式脑机接口 Nuromova 将专注度转化为可训练指标。创新奖得主 BrainBit 的 NeuroFeedback 2.0 系统实现人脑脑电波数据联动，例如结合人类放松方案与犬类焦虑缓解，拓展了 AI 在 ADHD、PTSD 管理及动物行为训练中的应用边界。

图32：喜乐健的家庭治疗舱 2.0 获得 CES 2026 创新奖



资料来源：智东西公众号

图33：玖治科技 Ringconn 打造智能戒指



资料来源：智东西公众号

(4) AI+宠物饲养硬件：宠物饲养设备通过 AI 实现全流程自动化与交互升级。深圳天和荣科技与 Bird Buddy 的智能喂鸟器具备防松鼠、AI 剪辑功能；FrontierX 推出 AI 原生宠物摄像头，整合安防与远程互动。中国品牌宠咕咕将如厕、饮水等饲养环节数据化，优克联的 PetPhone 支持宠物主动“拨号”通话，体现了 AI 在降低养宠负

担与增强情感连接方面的突破。

(5) 其他新型 AI+硬件：非主流场景的 AI 硬件同样展现技术普惠价值。会议设备如 Plaud 的录音硬件与出门问问的 TicNote 系列优化办公效率；翻译类设备如时空壶耳机、TOZO 翻译机提升跨语言沟通体验。创新奖产品 Bedivere 自主机器人导盲器通过离线 AI 导航助视障人士避障，雷蛇 Project Motoko 游戏耳机集成摄像头支持实时物体识别，反映了 AI 在无障碍与娱乐领域的深度整合。

图34: Bird Buddy 的智能喂鸟器已经形成完整生态



资料来源：智东西公众号

图35: 出门问问打造 AI 录音卡片 TicNote

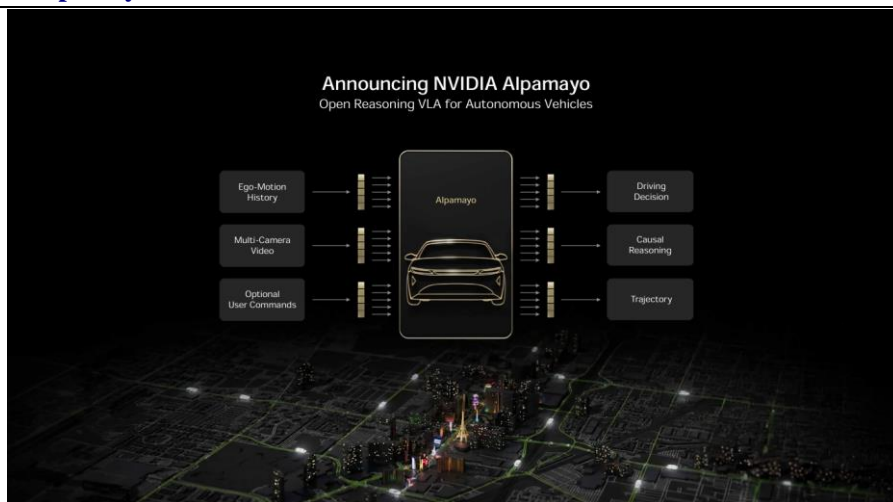


资料来源：智东西公众号

6、智能汽车：开源 AI 模型推动高阶自动驾驶加速落地

英伟达以开源物理 AI 模型与开放生态重塑高阶自动驾驶技术路径。在 CES 2026 上，英伟达将其智能驾驶布局的核心明确为以开放生态应对行业封闭体系，并发布了面向 L4 级的关键解决方案——开源物理 AI 推理模型系统 Alpamayo。该系统通过其视觉-语言-动作(VLA)架构赋予链式推理能力，旨在攻克自动驾驶的“长尾问题”，并包含开源模型 Alpamayo R1 及高保真仿真蓝图 AlpaSim，结合 Isaac Sim 等工具构建了“合成数据仿真训练-实车落地”的技术路径。此战略通过与梅赛德斯-奔驰的实车演示得到展现，标志着英伟达正通过软硬协同的开放平台，降低行业门槛，推动智能驾驶向高阶迈进。

图36: Alpamayo 是首款用于辅助驾驶的开源 VLA 推理模型



资料来源：英伟达官网

我们认为，英伟达开源端到端自动驾驶模型 Alpamayo R1，通过开放完整的开发堆栈与具备推理能力的 VLA 架构，显著降低 L4 级自动驾驶研发门槛，并有望加速行业生态重构与商业化进程。

中国车企集体展现出 AI 技术落地的迅猛势头。吉利升级全域 AI 2.0 体系，推出具备 L2 到 L4 全栈能力的“千里浩瀚 G-ASD”，并明确 2026 年 L3/L4 功能推送及 Robotaxi 商业化时间表；长城展示 ASL 2.0 智能体与 VLA 模型；零跑则联合高通推出双芯片跨域融合方案，实现智能座舱与辅助驾驶的深度协同。这些技术进展共同表明，AI 已从概念层面成为自动驾驶不可或缺的实践核心，推动行业从辅助驾驶向高阶智驾加速迈进，直面多元出行场景的差异化需求。

图37：吉利全域 AI 技术体系全面升级，进阶到 2.0 时代



资料来源：雷科技公众号

图38：Strutt 发布的 Ev1 智能电动轮椅



资料来源：极客公园公众号

图39：Verge 电动摩托车搭载固态电池



资料来源：极客公园公众号

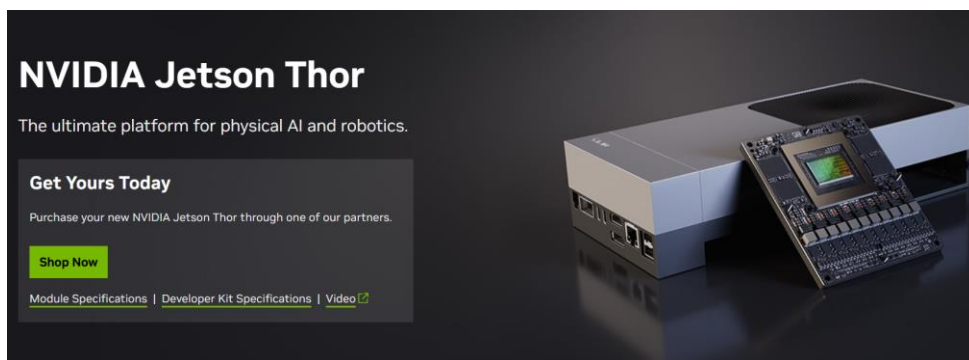
创新出行：从辅助智能到性能革命的双重突破。在 CES 2026 上，出行领域的创新呈现多元化深度突破。Strutt 公司推出的智能电动轮椅 Ev1，通过搭载 L4 级同源

传感器阵列与 Co-Pilot Plus 系统，实现了狭窄空间内的自动避障与路径规划，以“人机共驾”模式将出行辅助升级为安全、自主的“智能领航”。同时，Verge 公司宣布即将量产搭载固态电池的电动摩托车，其 400 Wh/kg 的能量密度、约 595 公里续航、10 分钟快充 300 公里以及千牛米级扭矩的动力系统，标志着电动两轮车在能量密度、补能效率和性能表现上达到了全新高度。两者分别从“普适关怀”与“极致性能”维度，展现了技术创新如何重塑不同场景下的出行体验与行业标准。

7、具身智能：各类形态百花齐放，具身智能加速落地

英伟达：在机器人领域构建以“物理 AI”为核心的系统性布局，其战略根基是强大的硬件算力与开放的软件生态。在硬件层面，公司通过新一代 Jetson Thor 芯片，为人形机器人提供高性能计算平台，基于 Thor 芯片的 Project GR00T 项目已实现机器人在复杂环境中的实时决策与精密操作。在软件与生态层面，英伟达依托 Isaac 机器人平台与 GR00T 通用基础模型，构建了集模拟训练、推理能力与真实部署于一体的全链路开发生态，并已与 Boston Dynamics、Franka Robotics 等全球领军企业展开合作，共同推动工业机械臂、人形机器人等多元形态产品向具备环境理解与自主决策能力的“推理型智能体”演进。

图40：英伟达通过新一代 Jetson Thor 芯片，为人形机器人提供高性能计算平台

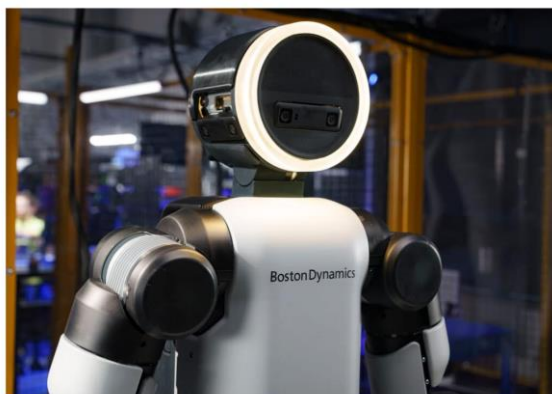


资料来源：英伟达官网

英伟达的布局正在重构机器人行业竞争范式：一方面，其通过“芯片+算法+软硬件生态”的系统级解决方案，将数据中心领域的垄断优势复制到物理世界，可能加速人形机器人商业化进程；另一方面，这种全栈式技术输出倒逼产业链升级，我国在传感器、精密制造等供应链环节的优势企业，有望通过与国产算力芯片适配实现差异化突破，但同时也面临被“锁定”在英伟达技术生态中的挑战。这种升维打击策略可能进一步强化其在新兴物理 AI 领域的话语权。

波士顿动力：新型 Atlas 机器人或将彻底改变行业格局。在 CES 2026 上，波士顿动力公司正式发布了其全电动人形机器人 Atlas 的量产商用版本，标志着其人形机器人技术从研发迈向规模化工业应用的关键一步。该机器人拥有 56 个自由度、2.3 米臂展与 50 公斤负载能力，具备快速学习、自主导航与强环境适应性，旨在执行物料搬运等复杂工业任务。公司宣布立即启动生产，计划于 2026 年率先交付现代汽车与谷歌 DeepMind，并于 2027 年扩展更多客户。同时，波士顿动力与谷歌 DeepMind 达成合作，将集成其 AI 基础模型以增强 Atlas 认知能力，并与现代摩比斯合作构建可靠供应链，通过核心部件标准化与汽车级制造体系，推动人形机器人的成本优化与大规模落地。

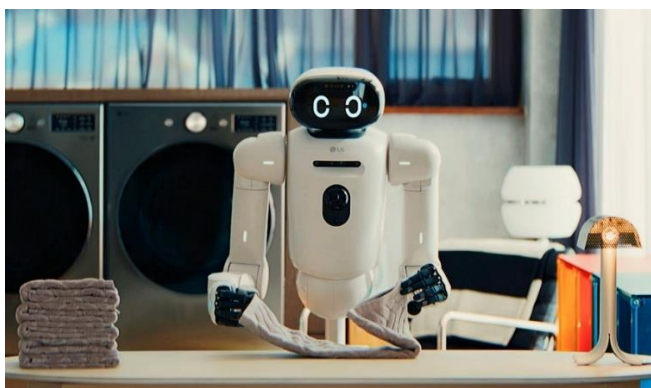
图41：波士顿动力在 CES2026 上发布全电动人形机器人 Atlas 的量产商用版本



资料来源：波士顿动力官网

LG 电子：推出首款人形机器人 CLOiD。大会上，LG 以“创新，与你同频共振”为主题，系统展示了其面向“物理 AI”时代的全栈式服务机器人战略布局。其核心是发布了 AI 家用机器人 LG CLOiD，该产品定位为移动的智能家居中枢，整合公司的视觉语言模型与视觉语言动作技术，能够理解并执行厨房备餐、洗衣折叠等复杂任务，并通过与 ThinQ 生态深度集成，协同全屋设备向“零劳动之家”愿景迈进。硬件上，其采用七自由度仿人机械臂与低重心轮式底盘，兼顾灵巧操作与安全性。更为关键的是，LG 同步推出了机器人执行器新品牌 AXIUM™，旨在将自身在家电电机领域的积累转化为模块化、高性价比的关节解决方案。这标志着 LG 的战略不仅是推出终端机器人产品，更是从核心零部件到整机、再到智能家居生态的全面延伸，旨在构建贯穿价值链的关键能力，以抢占未来家庭服务机器人市场的战略制高点。

图42：LG 推出首款人形机器人 CLOiD



资料来源：LG 官网

中国机器人企业呈现出多领域、全场景的协同布局。工业领域以智元机器人、星动纪元等为代表，聚焦非结构化环境下的复杂操作与物流自动化；服务领域覆盖家庭（如灵犀智能的情感陪伴机器人）与户外场景（如 JOYin 的自动露营机器人），强调交互能力与实用功能；核心技术方面，帕西尼的触觉传感器、星海图的 VLA 大模型等突破了灵巧操控与 AI 决策能力，而云深处科技的轮足式机器人则展示了复杂环境适应性。整体上，中国企业通过“硬件创新+场景落地”的组合，展现了从工业自动化到日常生活的完整生态链。

表2：中国机器人企业集体亮相 CES2026

公司名称	核心产品/亮点
智元机器人	展示包括灵犀 X2、远征 A2、精灵 G2 在内的全系列人形机器人，并进行群控舞蹈、复杂交互及在非结构化工厂环境下的操作演示。
傅利叶智能	展出新一代全尺寸人形机器人“GR-3”（昵称“猫猫头”），以“Care-bot”为概念，主打亲和、安全与情感交互，拥有 55 个自由度。
宇树科技	展示 G1 量产版、入门级 R2 及下一代 H2 型号人形机器人，并进行逼真的交互演示。
银河通用	展示通用人形机器人平台，强调在日常生活、医疗辅助等多场景的应用，重点演示运动稳定性和 AI 决策能力。
北京人形机器人创新中心	展出“具身天工 2.0”和“具身天工 Ultra”等多款机器人，现场演示全自主分拣零部件等作业能力。
星动纪元	携星动 L7、星动 Q5 等组成的人形机器人家族亮相。星动 L7 已在仓储物流领域应用；星动 Q5 可精准复刻操作人员的全身动作。
众擎机器人	全球首次亮相全尺寸通用人形机器人“众擎 T800”，在峰值扭矩、续航、灵巧手操控等方面有关键突破。
云深处科技	展示绝影系列升级版（如绝影 X30），为轮足式机器人，配备自研导航算法，重点演示复杂环境适应能力。
逐际动力	展示全新多形态具身机器人 TRON 2，集高性能操作双臂与全地形移动双足于一体，可作为“一站式”具身开发平台。
松延动力	首次携核心产品“小顽童 N2”参展，并计划在 2026 年第二季度进行大规模市场拓展。
加速进化	展示适用于赛事、教育等场景的具身开发平台 Booster K1
领益智造	首次参展，展示多款机器人整机骨架、16 自由度 3C 灵巧手及多机异构系统，演示巡检、分拣等工业应用
帕西尼	展示了高精度触觉传感器，具备 0.01N 的力检测分辨率。业界首款融合“多维触觉+AI 视觉”的 13 自由度灵巧手(DexH13),展示了 TORA-ONE 多维触觉人形机器人,拥有 47 个自由度,续航达 8 小时。推出了 OmniSharing DB 全模态数据集。
星海图	现场演示由 VLA 大模型驱动，完成复杂任务的人形机器人 R1 Pro。以及“慢思考+快执行”大模型。Galaxea Open-World Dataset 提及了其开源的大规模真实世界机器人操作数据集,该数据集在全球开发者社区中已被下载超过 40 万次，为模型训练提供了宝贵资源。
维他动力	展示其四足智能伴随机器人——大头 BoBo 智能机器狗。
斗山机器人	斗山机器人（Doosan Robotics）携其 Scan & Go 自主机器人解决方案亮相本届 CES。该方案已斩获 CES 创新奖人工智能（AI）类别“最佳创新奖”及机器人类别“荣誉提名奖”，是一款基于人工智能技术的自主机器人解决方案，专为大规模制造业及复合材料维修场景设计，可实现高危、劳动密集型复合材料维护工作的自动化。
灵犀智能	灵犀智能（Lynxaura Intelligence）展示其第一款重磅产品——AiMOON 星座 AI 守护精灵。作为全球首款结合星座文化和 AI 技术的情感陪伴机器人，AiMOON 不仅仅是一个会说话的搪胶毛绒玩具，更是一个拥有星座人格化、长期记忆与情感共鸣的 AI 陪伴者，为全球用户带来前所未有的陪伴体验。
擎朗智能	KeenMow 智能割草机器人采用 3D LiDAR 与 AI 视觉融合技术；配送机器人 T10 面向酒店、餐厅等场景的高端配送解决方案，针对不同面积的商业环境设计的自动化清洁机器人，体现了在无人化运维领域的成熟产品矩阵。
JOYin 乐享科技	展示其自动露营机器人 W-Bot 具备稳定的户外运动能力，强调交互能力与负载运输能力的结合，已获得多个行业的意向订单。Z-Bot 高度 60 厘米，拥有 20 个自由度，主打家庭场景下的通用服务与情感交互。
优理奇	拥有 Unitouch 视触觉大模型在内的多项研究成果，专注于解决机器人的泛化问题与长序列任务执行能力。

资料来源：具身机器人内参公众号、开源证券研究所

中国机器人企业以高密度的技术秀集中展示商业化落地的加速态势。宇树科技通过人形机器人 G1 的格斗赛引爆现场人气，其 R1 机器人以 4900 美元的定价彰显市场竞争力；智元机器人的“上纬启元 Q1”凭借灵巧力控设计完成海外首秀，成为全场焦点；众擎机器人则通过流畅的广播体操演示了关节协调能力。在 C 端市场，傅

利叶智能推出桌面级情感陪伴机器人“Care-bot”原型，维他动力的四足机器狗“大头Bobo”实现智能跟随与交互。商业化层面，魔法原子透露其 2025 年海外收入占比超 60%，工业级 MagicBot Gen1 已实现多机协作；加速进化的 Booster K1 在 CES 首日即售出数十台，而松延动力计划在 2026 年第二季度实现千台级市场拓展。我们认为，这些动态正表明，中国机器人企业正凭借硬件创新与场景化解决方案，从技术展示快速走向全球市场的规模化落地。

图43：宇树科技展示“机器人格斗赛”



资料来源：第一财经公众号

图44：智元机器人首次亮相海外



资料来源：第一财经公众号

8、投资建议

总结来看，2026 年 CES 展共有来自 150 多个国家和地区的约 4112 家企业参展。AI 仍然是 CES 展主旋律，但与往年不同的是，从 CES 2026 上我们看到生成式 AI 从软件层面更多地向物理世界的全面融合，除了传统智能手机/PC 等消费电子终端外，生成式 AI 全面赋能各类物理世界场景。在架构迭代和工艺制程持续优化的推动下，新一代 AI 芯片性能显著提升，推理成本显著下降，生成式 AI 持续赋能 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、各类新型 AI 终端、智能驾驶和具身智能机器人。我们认为，生成式 AI 带来的新一轮创新革命方兴未艾，AI 手机和 AI PC 等传统消费电子产品类有望受益消费者换机而进入周期上行通道，AI 眼镜、具身智能机器人已经跨过“0 到 1”进入“1 到 N”阶段，产品出货量有望保持高速增长，AI 硬件产业链受益标的：工业富联、立讯精密、歌尔股份、龙旗科技、传音控股、蓝思科技、领益智造、环旭电子、长盈精密、珠海冠宇、鹏鼎控股、东山精密、恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、汇顶科技、炬芯科技等。

表3：受益标的盈利预测与估值

Wind 代码	公司简称	评级	市值(亿元)	收盘价(元)	归母净利润(亿元)			PE (倍)		
			2026-01-12	2026-01-12	2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
601138.SH	工业富联	未评级	12,100	60.93	343.89	584.51	728.28	35.18	20.70	16.61
002475.SZ	立讯精密	未评级	4,039	55.43	169.26	214.64	263.02	23.86	18.82	15.35
002241.SZ	歌尔股份	未评级	1,084	30.56	33.36	42.21	51.34	32.48	25.67	21.10
603341.SH	龙旗科技	买入	244	51.80	6.42	9.04	12.73	37.93	26.95	19.14
688036.SH	传音控股	买入	823	71.47	31.47	44.82	59.23	26.15	18.36	13.89
300433.SZ	蓝思科技	未评级	2,254	42.66	50.48	67.47	82.33	44.66	33.41	27.38

Wind 代码	公司简称	评级	市值(亿元)	收盘价(元)	归母净利润(亿元)			PE (倍)		
			2026-01-12	2026-01-12	2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
002600.SZ	领益智造	买入	1,339	18.33	25.16	35.75	47.65	53.23	37.46	28.10
601231.SH	环旭电子	未评级	648	28.44	18.30	24.42	30.30	35.42	26.55	21.40
300115.SZ	长盈精密	未评级	619	45.45	6.85	9.89	12.94	90.28	62.52	47.79
688772.SH	珠海冠宇	买入	243	21.46	6.10	14.99	20.06	39.80	16.20	12.11
002938.SZ	鹏鼎控股	买入	1,203	51.91	45.14	55.15	65.02	26.66	21.82	18.51
002384.SZ	东山精密	买入	1,437	78.44	19.63	43.52	59.60	73.18	33.01	24.10
603160.SH	汇顶科技	未评级	386	82.90	8.34	10.21	12.18	46.25	37.80	31.68
688608.SH	恒玄科技	买入	431	255.50	9.76	12.53	16.74	44.15	34.40	25.75
688332.SH	中科蓝讯	未评级	180	149.40	3.68	4.52	5.67	48.98	39.87	31.76
688018.SH	乐鑫科技	买入	317	189.45	4.75	6.73	8.99	66.63	47.05	35.24
688049.SH	炬芯科技	未评级	100	57.29	2.02	2.80	3.74	49.70	35.87	26.82

资料来源：Wind、开源证券研究所（注：未评级标的采用 Wind 一致预期，已评级标的使用开源证券研究所预测值）

9、风险提示

（1）宏观经济波动风险：若宏观经济发生较大不利变化，电子行业下游需求疲软，将导致相关企业收入增速低于预期，盈利水平或将恶化。

（2）行业竞争格局恶化风险：国内电子行业上市公司在全球 AI 产业中主要参与上游硬件零部件环节，属于制造业，行业壁垒相对不高，若行业竞争加剧，存在利润率下行风险。

（3）AI 产业进展不及预期风险：目前 AI 产业上游芯片和算力投入较多，而下游终端应用仍有待起量，若 AI 产业发展不及预期，云厂商的 Capex 投入或因不可持续而缩减。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20% 以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5% 以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn